

	<p>破。</p> <p>3、公司目前的产能情况及技术优势？</p> <p>回复：公司已拥有从光芯片封装、光器件封装到光模块制造的垂直生产能力，随着市场开拓工作的进展，高速率模块、封装产线的产能得到了进一步的提升，未来中高速率产品占公司的产品比重预计将进一步提升。</p> <p>4、公司在数据中心市场拓展进展情况？</p> <p>回复：公司已与行业内主要客户建立了联系，目前各项工作均在稳步推进中，公司将力争抓住数据中心市场良好的市场机会实现新的突破。</p> <p>5、结合公司 2019 年一季度报告的情况，介绍公司 2019 年第一季度的整体经营情况。</p> <p>回复：2019 年第一季度，公司积极拓展国内外市场，加大研发力度，在客户拓展及产品结构转型升级方面均取得了较好的进展，实现了较好的经营业绩。</p> <p>☆ 本次调研中未涉及未公开重大信息泄密的情况</p>
附件清单（如有）	无
日期	2019 年 5 月 24 日